



H6306 导热硅脂

H6306 是一款高导热性能的导热硅脂，导热率可达到 6.0W/m·K。

产品特性

- 环境友好，对金属，PCB 等基材无腐蚀性；
- 优异的电气性能、化学性能、稳定性和耐候性；
- 良好的耐寒耐热性能，可在-40~200℃范围内长期使用；
- 高导热系数，操作性好；
- 无铅，符合 RoHS

应用领域

- 电子元器件：IC、CPU、MOS；
- LED、M/B、P/S、散热器、电脑；
- 液晶电视、通讯设备、无线接收器、笔记本电脑
- DDR 模块、DVD 应用

产品性能

典型性能参数

条目	典型值	备注
外观	灰色膏状	目视
密度 (g/cm ³)	2.5	ASTM D792
粘度 (cP)	245000	Brookfield
挥发物 (%)	1	ASTM E595
导热系数 (W/m.k)	6.0	ASTM D5470
最薄厚度(um)	35	ASTM D5470
热阻 (°Cin ² /W)	0.017	ASTM D5470
介电强度(KV/mm)	400	ASTM D149
使用温度 (°C)	-40~200	NA



产品使用

使用自动点胶机点胶时，设置好出胶量及点胶路径施胶到发热源元件面上，然后与散热元件压合好即可。若需要返修或多余的胶料可以用布条轻易擦掉。

注意事项

远离儿童存放；产品的使用不是涂的越多越好，而是在保证填满间隙的前提下越薄越好；若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用大量清水冲洗并到医院检查；详细资料请参阅本品的 MSDS。

标准包装

- 300ml/支，2600ml/支
- 根据客户要求单独包装。

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：0-35℃。有效期存储为 6 个月

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com